

お客様 各位

2011年 2月 9日
日本スパンション株式会社
マーケティング統括部
ビジネス・プロダクトマーケティング部
部長 佐藤 賢一

**Spansion 製 BGA パッケージ
銅ボンディングワイヤ及び新モールド樹脂の導入について**

拝啓

貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、弊社 BGA パッケージ製品につきまして、今後も継続的な安定供給に努めるべく銅ボンディングワイヤ及び新モールド樹脂の導入を図ってまいります。ご多用中まことに恐縮に存じますが、内容をご賢察の上ご了承下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。なお、本件につきまして何かご不明な点がございましたら、当社担当営業または特約店までお問い合わせ下さいませますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

— 記 —

1. 対象品種

S25FL032P, S25FL064P, S25FL129P, S29AL008J, S29AL016J, S29AS008J, S29AS016J,
S29GL032N, S29GL064N, S29JL032J, S29JL064J, S29PL032J, S29PL064J, S29PL127J,
S29VS064R, S29VS128R, S29VS256R, S29WS064R, S29WS128P, S29WS256P, S29WS512P,
S29XS064R, S29XS128R, S29XS256R

注：カスタム型格も対象に含まれます。

2. 対象パッケージ

対象品種の全ての単体 BGA パッケージ

3. 理由

生産の効率化および継続的な安定供給。

4. スケジュール

評価用サンプル： 3月上旬

量産出荷開始： 5月上旬

5. 信頼性について

従来品と同等の信頼性、特性を確保しております。信頼性データおよび特性調査結果が必要な場合は弊社担当営業又は、特約店担当営業までご要求願います。

-以上-